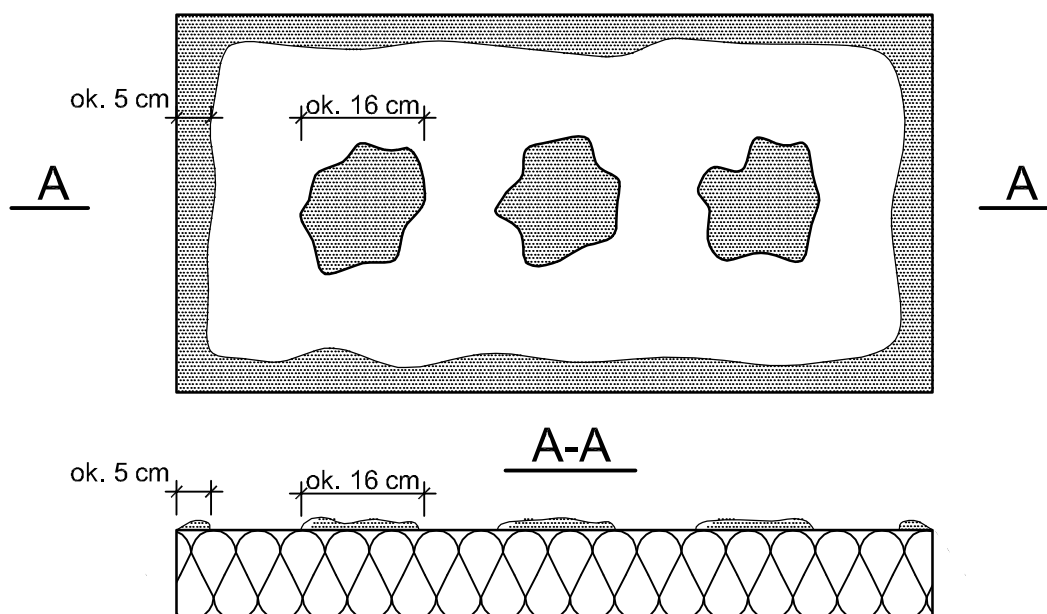
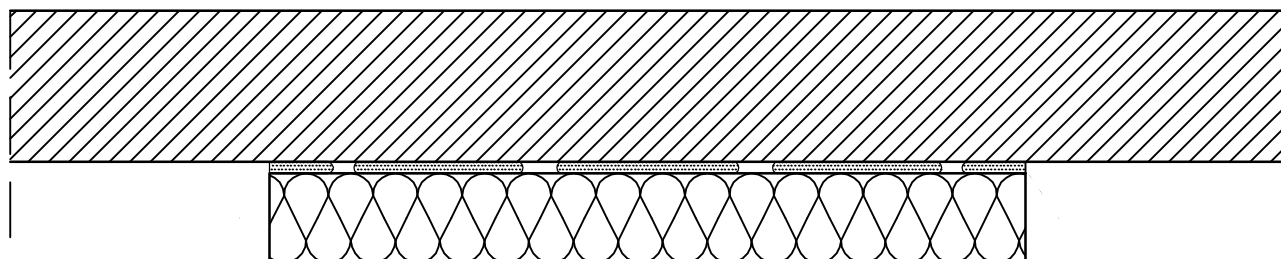


SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ



Uwagi!

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspresyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje/karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspresyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płycie nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płyte termoizolacyjną całościowo przy użyciu pasy zembatej (ok. 10mm).

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

EKOPROBUD
Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud

Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Janasa 17
41-700 Ruda Śląska

TYTUŁ:

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. JANASA
17 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

TYTUŁ RYSUNKU:

SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

BRANŻA:
ARCH.

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. L. Wiśniowski nr upr. 743/87

PODPIS:

03-2020

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK

PODPIS:

SKALA:
1:10

OPRACOWAŁ:

inż. Karolina Krajewska

PODPIS:

NR RYS.

KIEROWNIK BIURA:

dr inż. T. Muzyczuk

PODPIS:

9